

芯月刊

肇其基
启其运

2026年1月26日
乙巳年 腊月初八
内部刊物 仅供交流

主办单位:



北京集成电路学会 中关村集成电路产业化联盟

总第1期
本期4版

2026年1月26日创刊
每月最后一个周一发刊

XYK-NK-2026-001



北京半导体行业协会

热烈祝贺《芯月刊》创刊！

岁启新章，芯向未来。借此之际，北京集成电路学会内部交流刊物正式创刊，首期于2026年1月26日与各位见面。本刊为内部交流之用，不对外公开发行、不做盈利售卖，定于每月最后一周的周一发刊，旨在梳理集成电路业界动态，沉淀专项调研成果，为全体会员打造专业、高效的行业交流平台。

方寸芯片，承载产业发展之重；点滴洞察，汇聚行业前行之力。本刊将秉持专业、客观、务实的原则，定期传递行业资讯，精准呈现研究成果，助力会员把握产业脉搏，为政府决策提供参考。愿以本刊为媒，凝聚行业智慧，共促北京乃至全国集成电路产业创新发展，携手书写芯领域新篇章！

《芯月刊》编辑部（北京集成电路学会、中关村芯链集成电路产业联盟、北京半导体行业协会）于京

国际形势/政策

中国台湾出口至美国的关税税率将调降至15%

《纽约时报》1月12日引述三名知情人士报导，特朗普政府正接近与中国台湾达成一项协议，内容包括将中国台湾出口至美国的关税税率调降至15%，并要求台积电承诺在亚利桑那州再兴建至少五座晶圆厂设施。该协议目前正在行文本审议与修订，最快可望于本月对外宣布。

知情人士透露，协议一旦拍板，中国台湾输美商品的关税税率将降至15%，与日本与韩国的水准一致，两地区已去年与美国达成类似贸易协议。

其中一名知情人士表示，作为协议的一部分，台积电将承诺在美国亚利桑那州再兴建至少五座半导体工厂，使其在当地厂区规模大约增加一倍。

（来源：钜亨网）

美国正式批准英伟达H200芯片对华出口但有三大受限条件

美国商务部周二（1月13日）发布的一项规定表示，将逐案审查人工智能芯片出口到中国的申请。这些规定包括（1）证明美国境内不存在处理器短缺。寻求出口许可的公司必须证明，为中国客户生产芯片不会挤占原本可用于为美国国内买家生产芯片的产能，且不得将这些芯片用于军事用途。（2）这些公司向中国出口芯片的数量将受到限制，不得超过其面向美国市场生产产品总量的50%。（3）这些公司还必须“采取严格的安全尽职调查”程序，以防止未经授权使用该技术。这些芯片还将在美国接受第三方的性能测试。

这项监管规定标志着落实特朗普总统上个月允许英伟达和其他芯片制造商向中国出售先进人工智能处理器的决定迈出了关键一步。（来源：集微网，北京集成电路学会整理）

2025年我国集成电路出口创2019亿美元新高，连续26个月同比增长

据海关总署公布，2025年我国货物进出口总值为63547.7亿美元，同比增长3.2%。出口37718.7亿美元，同比增长5.5%。进口25829亿美元，与2024年持平。

2025年我国机电产品出口量增质升主要表现在以下四个方面：一是规模总量创新高。机电产业链供应链韧性和货物出口的结构性升级趋势。

二是增速实现阶段性飞跃。“十四五”时期机电产品出口增速达到8.36%，打破了长期以来的增长瓶颈，也为衔接“十五”发展目标、推动产业链供应链提质升级奠定了承上启下的良好局面。

四是行业结构继续优化。海关总署公布的12大类机电产品中，集成电路、汽车整车、汽车零配件等8个品类出口实现增长。其中，汽车出口创造832.4万辆的新高，较上年高出近200万辆；集成电路出口创2019亿美元的新高，连续26个月同比增长。汽车、集成电路、船舶等新兴行业和高附加值行业出口比重提升，合计拉动机电出口增幅3.7个百分点。

（来源：集微网，北京集成电路学会整理）

国内政策

北京产业用地新政：集成电路等重大产业项目可获30-50年土地使用权

2025年12月31日，北京印发了《关于加强产业用地弹性年期出让工作的若干意见（试行）》（以下简称《意见》），深化完善了全市产业用地弹性年期出让政策的实施和管理要求，包括合理划分年期、优化地价核算方法、明确续期条件等。

《意见》提出，结合不同产业类型特点和需求，构建多类型产业用地梯次供应体系，丰富各区招商引资“工具箱”。一般产业项目用地按照不超过20年期（含20年期）出让，位于产业园区内的相关项目，可分类划分为执行年期。其中，国家级重大产业项目以及集成电路、智能网联新能源汽车、生物医药、航空航天等投资强度大、回报周期长的市级、区级重大产业项目的用地，可按照30—50年期出让。（来源：北京市人民政府、集微网）

北京市出台中试“十四条”措施，最高1亿元支持

2026年1月4日，北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会联合印发《关于进一步提升本市中试服务能力促进科技创新和产业创新融合发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），提出对于人工智能、医药健康、绿色低碳、机器人与智能制造等国际引领产业，新材料、集成电路、空天技术、新型安全应急等固本强安产业，以及未来产业成长阵列，建设一批中试平台，对符合市政府固定资产投资支持条件的新建项目按照项目总投资35%，最高不超过1亿元予以补助支持。

《若干措施》提出围绕重点产业梯度布局中试平台、推动龙头企业建设中试生产线、支持建设综合性中试公共服务机构、强化中试平台建设服务保障、推动现有开放平台开放中试服务功能等14条具体措施。（来源：集微网）

上海“十五五”规划建议：提高集成电路装备能级、制造水平和设计能力

近日，中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十个五年规划的建议发布，提出加快发展三大先导产业，提高集成电路装备能级、制造水平和设计能力，推动全产业链整体突破和发展壮大；要加强原创药械研发，坚持药物靶点新机制开发、成果转化加速、临床试验提效、多元支付创新等综合施策，促进生物医药高端高效发展；推动人工智能全栈创新，加强高性能智算芯片、高质量药效、高效能智算集群协同发展，推动基础大规模迭代升级和具身智能技术熟化，深入实施“人工智能+”行动，持续推进“模塑申城”工程，加快垂类模型应用和多智能体开发，深化人工智能治理。（来源：集微网）

国家发改委：研究设立国家级并购基金

国务院新闻办公室20日举行新闻发布会，介绍落实中央经济工作会议精神，推动“十五五”实现良好开局有关情况。国家发展改革委副主任吕晶晶在会上称，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快构建现代化产业体系。实体经济是我国经济发展的根基，要适应产业转型升级的需要，通过创新不断催生新的供给，催生新的就业岗位。坚持智能化、绿色化、融合化方向，推动重点产业提质升级，大力培育壮大新兴产业和未来产业，深入开展“人工智能+”行动。要发挥好国家创业投资基金行业标杆作用，研究设立国家级并购基金，加强政府投资基金布局规划和投向指导，促进创新创业创造，加快培育和发展新质生产力。（来源：中国经济周刊）

企业新闻

杭州芯光半导体高端先进芯片全国测试基地奠基

1月13日上午，杭州芯光半导体有限公司高端先进芯片全国测试基地（一期）奠基仪式于杭州滨富特别合作区举行。

据股东代表广发乾和策略投资部总经理朱保力介绍，朗迅芯云在前沿领域持续拓展测试版图，芯光半导体是公司攀登产业高峰的一座里程碑，代表公司向成为兼具规模优势、肩负更大产业使命的公众公司迈出了至关重要一步。股东代表杭州禾合创业投资有限公司总经理翁佳燕指出，芯光半导体是朗迅芯云产业链延伸的关键布局，也是滨富合作区赋能的重要成果。勉励朗迅芯云保持高速增长，造就技术领先、效益优良的半导体先进标杆。据杭州发布1月5日消息，杭州芯光半导体有限公司高端先进芯片全国测试基地项目是今年新开工的省“千项万亿”工程项目。公开消息显示，杭州朗迅科技股份有限公司创立于2010年，是国内领先的集成电路测试综合服务商，专注于集成电路领域研发、先进芯片全流程测试服务及产业人才生态建设。（来源：集微网）

中微半导推出首款非易失性存储芯片

1月19日，中微半导发布自愿性公告，宣布即将推出首款非易失性存储器芯片，标志着公司正式进军Flash领域。

本次推出的新产品型号为CMS25Q40A，是一款4M bit容量的低功耗SPI NOR Flash芯片。其存储阵列划分为2048个可编程页，每页容量256字节，单次编程操作最多可写入256字节数据。该芯片支持多种擦除方式，包括1KB扇区擦除、4KB扇区擦除、32KB块擦除、64KB块擦除及整片擦除，具备低成本、低功耗、SPI高速读写、掉电不丢失等核心特点。

在性能参数方面，该芯片采用1.65V至3.6V单电源供电，全系列采用小型封装以节省空间；支持标准串行外设接口（SPI），兼容双路/四路输出模式及双路/四路输入输出（I/O）SPI模式，最高SPI时钟频率可达120MHz；配备保持引脚、写保护引脚及可编程写保护功能，可灵活控制存储阵列不同区域的写保护状态；同时具备安全性，包含1024字节安全存储器、一次性可编程锁定功能及内置64位唯一序列号，Page编程时间为1.25ms。

应用场景上，该产品适配小存储需求场景，涵盖嵌入式MCU程序存储、小型智能硬件配置存储、低功耗IoT终端存储以及外设/模块配套存储等领域。

据介绍，本次CMS25Q40A产品的发布，是中微半导实施“MCU+”战略的最新成果，成功填补了公司在Flash领域的空白，标志着公司正式向存储领域迈出实质性一步。这一举措彰显了公司技术创新与产品开发能力的拓展，为后续拓展Flash产品阵容谱系、推进Flash产品系列化奠定了坚实基础。

同时，新产品的推出进一步丰富了公司的产品矩阵与产品形态，拓宽了应用场景范围，增强了公司在智能控制解决方案上的一站式整体解决能力，有助于巩固和提升公司综合竞争力，为开拓存储新市场、挖掘业务增长极提供有力支撑。（来源：集微网）

注册资本1亿元，沐曦股份

在上海成立数智科技公司

天眼查工商信息显示，1月20日，沐曦数智（上海）科技有限公司成立，法定代表人为陈维良，注册资本1亿人民币，经营范围包括集成电路设计、电子产品销售、集成电路芯片及产品销售等。股东信息显示，该公司由沐曦股份（688802）全资持股。

沐曦股份专注于全栈高性能GPU芯片及计算平台的自主研发，主营业务覆盖人工智能训练与推理、通用计算及图形渲染等领域，致力于提供高性能GPU芯片及相关软件栈与计算平台解决方案。（来源：财联社）

投融资新闻

西安半导体产业链发展基金落地，总规模50亿元

天眼查显示，2025年12月25日，西安半导体产业链发展基金合伙企业（有限合伙）在西安市经济技术开发区注册成立，出资额为100000万人民币，执行事务合伙人为西安经发资产管理有限公司。

据陕西日报报道，西安半导体产业链发展基金合伙企业由西安经开金融控股有限公司及其旗下基金管理平台——西安经发资产管理有限公司，联合陕西省半导体产业核心平台企业——陕西芯材科技产业发展有限公司共同发起设立。该基金总规模达50亿元，首期规模10亿元，存续期限设定为7年，采用“5+2”模式（5年投资期与2年退出期）。西安经开区管委会相关负责人介绍，此次基金设立是落实陕西省、西安市半导体产业发展战略部署的关键举措，将为经开区打造全国半导体创新高地注入强劲动力。（来源：集微网，北京集成电路学会整理）

国产半导体高端材料公司融资过亿，头部客户批量导入

中国半导体材料企业，北京序轮科技有限公司（简称“序轮科技”）于近日完成总额超亿元的A3、A4轮融资。由北方华创旗下产业基金诺华资本、北京电控产投基金与前海方舟基金投资。资金将重点投入于产线与配套体系的升级，以把握市场化规模化量产的关键机遇；同时，也将在研发创新与人才建设上持续加码，为长期竞争力提供坚实支撑。

半导体封装材料，尤其是高端功能性胶膜/胶带，长期被日本企业垄断，国产化率极低。随着产业链对自主可控的重视程度日益提升，叠加国内先进封装产能的快速扩张，市场对高性能国产材料的替代需求持续升温，行业空间广阔。

序轮科技成立于2022年5月（其前身团队于2016年进入半导体材料领域），专注于半导体先进封装工艺所需的高分子胶膜/胶带材料，包括UV减粘膜、DAF（芯片贴装胶膜）、IBF绝缘堆积极、新能源汽车用功能胶带，以及液体和薄膜类集成电路塑封料等。随着产品在众多头部客户处完成验证导入，公司业务已进入稳步放量爬升阶段。目前产能可对应约5亿元销售额的规模。（来源：硬氪）

兆易创新首挂上市定价162港元涨47.53%

1月13日，国内存储芯片龙头兆易创新（03986.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，完成“A+H”双资本平台构建的关键一步。公司本次H股发行定价为每股162港元，首挂表现强劲，截至早盘发稿，股价大涨47.53%至239港元，成交额达11.16亿港元，盘中一度上涨超50%，彰显市场高度认可。

据悉，兆易创新本次全球发售2891.58万股H股，每手100股，香港公开发售占比约10%，国际配售占比91.3%，全球发售净筹约46.11亿港元。招股价段公司便获市场热捧，香港公开发售获542.22倍超额认购，有效申请数目约14.84万份；国际配售也获18.52倍超额认购，足见全球投资者对其投资价值的信心。

作为多元芯片集成电路设计企业，兆易创新核心产品涵盖Flash、利基型DRAM、微控制器等，广泛应用于消费电子、汽车、工业等多领域，是国内少数在多项核心存储与控制芯片领域实现全球对标的公司。本次募资净额约75%将投向研发投入及行业并购，其余用于全球扩张和运营优化，助力公司进一步巩固行业地位、拓展国际市场。

此次上市后，兆易创新港股总市值飙升，结合其A股市值，双平台市值合计超3200亿元。分析认为，公司成功登陆港股，不仅打通境外融资通道，也为中资半导体企业在港股市场的估值重构提供了新样本，对国产半导体行业发展具有重要意义。（来源：集微网）

中科仪顺利过会，国产集成电路真空泵龙头即将上市

1月16日，国科控股旗下企业中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（简称“中科仪”）的IPO申请在深交所成功过会。根据之前的招股说明书，中科仪是中国科学院下属专注于洁净真空、超高真腔技术的国家级高新技术企业。

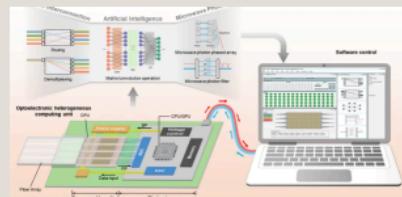
本次发行，中科仪拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5200万股（未考虑超额配售选择权），若全额行使超额配售权，发行总数将不超过5980万股。发行价格为后续询价或定价确定。募集资金将主要用于干式真空泵产业化基地建设、补充流动资金等项目，以进一步扩大产能、提升研发实力。（来源：仪器信息网，北京集成电路学会整理）

烁科中科信获尚颀资本投资，加速半导体离子注入机国产化进程

据尚颀资本消息，近日，尚颀资本完成对北京烁科中科信电子装备有限公司（以下简称“烁科中科信”）的投资。

尚颀资本消息指出，投资团队认为：“半导体设备是产业链安全的核心环节，离子注入机作为前道核心装备，技术壁垒高、国产替代需求迫切。烁科中科信凭借全系列产品自主可控能力、领先的市场份额与扎实的盈利表现，已成为推动离子注入机国产化的核心力量。此次尚颀资本携手烁科中科信，持续助力突破离子注入机‘卡脖子’技术壁垒，成为国内半导体产业链自主可控发展注入新动能。”（来源：集微网）

中科院半导体所在高精度光计算领域取得新进展



该架构通过噪声自学习机制，实现了光学与电学参数联合优化与自适应计算精度补偿。实验结果表明，采用4-bit的OPU时，ECA在MNIST手写数字识别任务（计算机视觉领域的经典任务）上的推理准确率达到90.8%，接近8-bit传统统计架构（TCA）的理论极限（90.9%），这表明光计算系统在低硬件精度仍能实现高精度推理，为高性能计算架构的设计提供了新思路。该OPU支持30.67 Gbaud/s的运算速率，实现981.3 GOPS的计算能力与3.97 TOPS/mm²的计算密度。

相关研究成果以“End-to-End Closed-loop Optoelectronic Computing Breaking Precision-Accuracy Coupling”为题发表于《先进光子学》（Advanced Photonics）。半导体所博士生李俊燊与博士后孟祥彦为共同第一作者，半导体所李明研究员、石暖暖研究员与西班牙瓦伦西亚理工大学José Capmany教授为共同通讯作者。（来源：中国科学院半导体研究所）

GB/T 46894-2025《车辆集成电路电磁兼容试验通用规范》国家标准发布

为进一步规范和提升车辆集成电路电磁兼容检测和技术能力，电子标准院电磁技术研究中心主办的GB/T 46894-2025《车辆集成电路电磁兼容试验通用规范》于2025年12月31日经国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准正式发布。

GB/T 46894-2025《车辆集成电路电磁兼容试验通用规范》规定了车辆集成电路电磁兼容性能的通用试验要求和方法，适用于车辆集成电路150 kHz~6 GHz频率范围内的射频发射和射频抗干扰度以及脉冲抗干扰度和系统级ESD。主要技术内容包括试验大纲、试验限值、试验方法和试验报告。

该标准是我国统一车规芯片电磁兼容测试方法的关键标准，其有效填补了国内空白。

CES 2026国际消费电子展落幕：处理器、存储器、第三代半导体开启科技新纪元

当地时间1月9日，拉斯维加斯消费电子展（CES 2026）圆满落幕。本届展会以“Smarter AI for All”为主题，聚焦技术落地与场景应用。3600余件参评产品勾勒出科技发展的全新轨迹。从巨头到初创企业，都在聚焦一个核心命题：如何让科技更可靠、更可信，真正融入日常而不成为负担。本届CES传递的核心信号是“科技从展示走向落地”。

处理器大厂在数据中心与消费级市场双线发力。AMD、英伟达均带来多款新品，制程突破，算力飙升；随着AI算力爆发，存储器重要性凸显。SK海力士展示16层堆叠HBM4内存，为下一代AI加速器提供关键支撑。三星预警内存供应短缺。面对AI数据中心和电动汽车的功耗挑战，第三代半导体技术大放异彩，能效革命聚焦关键领域。

近900家国内企业组团亮相CES 2026。传统家电巨头与创新科技企业齐聚，参展重点集中在家电、自动驾驶、具备智能、AI眼镜等领域。（来源：集成电路前沿）

在人工智能神经网络高速发展的背景下，大规模的矩阵运算与频繁的数据迭代给传统电子处理器带来了巨大压力。光电混合计算通过光学处理与电学处理的协同集成，展现出显著的计算性能，然而实际应用受限于训练与推理环节分离、离线权重更新等问题，造成信息熵劣化、计算精度下降，导致推理准确度低。

提出了一种基于相位像素阵列的可编程光学处理单元（OPU），并结合李雅普诺夫稳定性理论实现了对OPU的灵活编程。在此基础上构建了一种端到端闭环光电混合计算架构（ECA），通过硬件—算法协同设计，实现了训练与推理的全流程闭环优化，有效补偿了信息熵损失，打破了光计算中计算精度与准确度之间的强耦合关系。

我国首台！芯片制造核心装备取得重要突破

近日，由中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机（POWER-750H）成功出束，核心指标达到国际先进水平。这标志着我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术，攻克了功率半导体制造链关键环节，为推动高端制造装备自主可控、保障产业链安全奠定坚实基础。

离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造“四大核心装备”，是半导体制造不可或缺的“刚需”设备。此次高能氢离子注入机的成功研制，是核技术与半导体产业深度融合的重要成果，将有力提升我国在功率半导体等关键领域的自主保障能力，更为助力“双碳”目标实现、加快形成新质生产力提供强有力技术支撑。

长期以来，我国高能氢离子注入机完全依赖国外进口，其研发难度大、技术壁垒高，是制约我国战略性产业升级的瓶颈之一。原子能院依托在核物理加速器领域数十年的深厚积累，以串列加速器技术作为核心手段，破解一系列难题，完全掌握了串列型高能氢离子注入机从底层原理到整机集成的正向设计能力，打破了国外企业在该领域的技术封锁和长期垄断。

（来源：中国原子能科学研究院）

西安电子科技大学郝跃院士张进成教授团队攻克芯片散热世界难题

近日，郝跃院士张进成教授团队通过将材料削的“岛状”连接转化为原子级平整的“薄膜”，使芯片的散热效率与综合性能获得了飞跃式提升。这不仅打破了近二十年的技术停滞，更在前沿科技领域展现出巨大潜力，相关成果已发表在国际顶级期刊《自然·通讯》与《科学·进展》。

团队的突破，在于从根本上改变了氧化铝层的生长模式。他们创新性地开发出“离子注入诱导成核”技术，将原来随机、不均匀的生长过程，转变为精准、可控的均匀生长。这项工艺使氧化铝层从粗糙的“多晶岛状”结构，转变为原子排列高度规整的“单晶薄膜”。这一转变带来了质的飞跃：平整的单晶薄膜大大减少了界面缺陷，热可快速通过缓冲/成核层导出。实验数据显示，新结构的界面热阻仅为传统“岛状”结构的三分之一。其核心价值在于，它成功地将氧化铝从一种特定的“粘合剂”，转变为一个可适配、可扩展的“通用集成平台”，为解决各类半导体材料高质量集成的世界性难题，提供了可复制的中国范式。

（来源：西安电子科技大学）

集群生态

京津冀七大国家先进制造业集群，发展重点定了

河北日报1月21日报道，前不久，京津冀集成电路集群、京津冀智能网联新能源汽车集群等京津冀区域内5个先进制造业集群入围国家先进制造业集群。目前，京津冀地区共拥有7个国家先进制造业集群。下一步，这七大集群发展重点是什么？近日，京津冀（经信）部门相关负责人进行了介绍。

京津冀集成电路集群力争2028年实现销售收入4500亿元

集成电路产业是电子信息产业的核心与命脉。三地将聚焦打造支撑我国集成电路产业自立自强发展的关键技术底座和前沿技术创新主阵地，全面推进京津冀集成电路产业“设计—制造—应用”全链贯通发展，力争2028年实现销售收入4500亿元，培育百亿元收入企业20家以上。

加快形成产业链联合攻关、互补共建机制。深化“研发迭代+规模量产”的攻关模式。谋划建设前沿技术攻关联合创新平台，组织企业开展先导技术探索。建好高性能芯片研发试片平台、检验检测服务平台以及创新孵化平台，推动先进计算架构创新迭代，为广大企业的研发创新构建共性服务平台体系。推广集群内供应链协同、创新能力共享、数据协同开放和产业生态融通发展等新模式，打造更开放、包容的创新环境。

加快设计、制造、应用全链贯通发展。通过组建IP服务平台等举措支撑京津冀高端芯片设计能力提升，以北京制造能力为依托，共同推动国产装备升级、加快国产材料攻关，加速先进封测产线建设，具备全链条生产能力。

加快建设多层次高水平人才队伍。推动北京产教融合基地向津冀地区拓展，推动集群人才“共育”。试点建设集群人才联盟，探索集群人才“共享”。用好京津冀各类人才支持政策，引入一批高水平领军人才。（来源：河北日报）

顺义诞生超宽禁带半导体核心平台

近日，随着北京市未来产业育新平台第二批建设名单公布，聚焦超宽禁带半导体材料方向的市级未来产业平台在顺义诞生，标志着顺义区在前沿科技产业布局中抢占关键先机，为北京国际科技创新中心建设注入了新动力。

近年来，顺义区重点打造第三代等先进半导体产业集群，并出台专项扶持政策，从研发流片、重大成果落地到人才引进给予全方位支持。此次市级平台的认定，正是区域产业政策与企业发展同频共振的结果。

未来，平台将吸引从装备、设计到应用端的优质企业聚集，在顺义形成国内领先的第四代半导体产业生态圈，为北京市第四代半导体氧化镓产业前进步伐打下坚实基础。

（来源：顺义区人民政府）

国家级战略布局落地！12家全国重点实验室构建半导体全产业链创新矩阵

未来半导体1月13日报道，随着国家科技部主导的全国重点实验室重组工作全面完成，半导体产业迎来重大利好消息。在此公布的500余家全国重点实验室中，半导体领域成为布局重点，共有12家实验室入选，覆盖从材料、设计、制造到应用的完整产业链环节。据了解，此次半导体相关实验室的布局体现了国家对该领域的高度重视。在芯片设计环节，中国科学院计算技术研究所与中国科学技术大学共建的“处理器芯片全国重点实验室”将聚焦自主CPU架构研发；北京大学的“微纳电子器件与集成技术全国重点实验室”致力于突破先进制程技术瓶颈。在半导体材料领域，浙江大学的“硅及先进半导体材料全国重点实验室”专注基础材料研究，而西安电子科技大学的“宽禁带半导体器件与集成技术全国重点实验室”则重点攻关第三代半导体技术，为5G通信、新能源汽车等战略性产业提供支撑。特别值得关注的是，此次布局还体现了产学研深度融合的特点。株洲中车时代电气与湖南大学共建的“功率半导体与集成技术全国重点实验室”将直接服务于轨道交通产业发展；北京中星微电子联合东南大学等高校的“数字感知芯片技术全国重点实验室”则瞄准人工智能芯片的自主可控。澳门大学与澳门科技大学联合建设的“模拟与混合信号集成电路全国重点实验室”入选，标志着半导体领域的国家创新体系进一步扩大开放，融入粤港澳大湾区建设。

业内专家指出，此次半导体领域国家重点实验室的集中布局，将有效整合高校、科研院所和企业的创新资源，形成攻关合力，有望在EDA工具、特色工艺、先进封装等关键环节取得突破，为提升我国半导体产业自主创新能力提供坚实基础。科技部相关负责人表示，下一步将加强对这些实验室的考核评估，建立动态调整机制，确保其真正发挥战略科技力量作用，助力解决半导体领域“卡脖子”问题。（来源：未来半导体）

人才培养

北京出台专项措施支持卓越工程师队伍建设 让扎根一线的工程师有奔头有舞台

1月4日召开的北京高层次创新创业人才座谈会，发布了《关于加强卓越工程师队伍建设的若干措施》（以下简称《若干措施》），从产教融合载体搭建、后备人才培养、人才集聚引育、成长发展激励等方面推出18条具体举措，为卓越工程师队伍建设提供“全链条”支持，让扎根一线的工程师有奔头、有舞台。

《若干措施》由市委教育科技人才工作领导小组办公室印发，旨在培养建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍，服务支撑首都高质量发展。

《若干措施》将产教融合载体建设作为核心抓手，明确在集成电路、人工智能、生物医药、新能源等重点产业领域布局产教融合创新联合体，建立企业、高校、科研院所多方参与的实体化运行机制，打造技术攻关与人才培养一体化平台。

市人才局有关负责人表示，北京将全面落实中央部署要求，聚焦国际科技创新中心和高水平人才高地建设，推动《若干措施》各项内容落地见效。通过全周期、多维度的支持体系，推动科技创新与产业创新深度融合，吸引更多卓越工程师扎根北京、建功立业，为首都高质量发展提供坚实的人才支撑。下一步还将开展卓越工程师表彰奖励活动，建立工程师常态化联系服务机制，推动工程师文化进高校、进企业、进园区，让实干奋斗精神在京华大地蔚然成风。（来源：北京市人民政府网站-政策解读）

叶甜春研究员当选IEEE Fellow

华大九天与西电签署战略合作协议，聚焦EDA电磁场仿真

近日，美国电子电气工程师学会（Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE）公布了2026年度IEEE会士（Fellow）名单。中国科学院微电子研究所叶甜春研究员因对先进器件科学与技术所做的贡献及其在中国的社会影响入选。

叶甜春是我国集成电路(IC)工艺与器件领域主要学术带头人之一。曾任中国科学院微电子研究所所长。30多年来，在IC先导工艺与器件、纳米加工等核心技术上取得了突出的创新成果，先后荣获国家技术发明二等奖3项、中国科学院杰出科技成就奖1项、中国科学院科技促进发展奖1项、省部级科技进步奖7项。其获得发明专利授权超过120项，在国际一流学刊和会议等发表300多篇学术论文，培养硕、博士生200多名。作为专项技术总师，组织集成电路产业链上下游紧密协同开展科技攻关，为推动我国集成电路从工艺到装备的技术水平实现跨越发展做出了重大贡献。（来源：中国科学院微电子研究所）

1月16日，北京华大九天科技股份有限公司与西安电子科技大学举行战略合作框架协议签约仪式，双方将围绕EDA电磁场仿真和多物理场仿真领域开展战略合作。

西电校长高新波表示，此次战略合作是校企双方响应国家战略、实现优势互补的重要举措，希望以此次签约为契机，在技术攻关、人才培养、成果转化等方面开展全方位、深层次合作，共同为我国集成电路产业高质量发展贡献力量。

华大九天党委书记、董事长刘伟平表示，华大九天与西电有着良好的前期合作基础，双方将结合华大九天在EDA领域的技术积累与产业资源，以及西电在电磁场及多物理场领域的学科科研实力和顶尖技术团队，快速补齐华大九天相关领域工具短板，加快科研成果转化进程，打造校企协同创新的典范模式。（来源：集微网）